

Title (en)
HEAT PUMP DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Title (de)
WÄRMEPUMPENVORRICHTUNG, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

Title (fr)
DISPOSITIF DE POMPE À CHALEUR ET MÉTHODE DE FABRICATION D'UN TEL DISPOSITIF

Publication
EP 3473948 A1 20190424 (DE)

Application
EP 18199521 A 20181010

Priority
DE 102017218528 A 20171017

Abstract (de)
Die Erfindung geht aus von einer Wärmepumpenvorrichtung mit zumindest einer Aufnahmeeinheit (32) zu einer Aufnahme einer Elektronikeinheit (20) und mit zumindest einer Gehäuseeinheit (14), an der die Aufnahmeeinheit (32) angeordnet ist. Es wird vorgeschlagen, dass die Wärmepumpenvorrichtung zumindest eine Auffang- und/oder Ablaufeinheit (24) umfasst, welche dazu vorgesehen ist, zumindest ein, insbesondere in die Gehäuseeinheit (14) eingedrungenes, Fluid zu sammeln und von der Aufnahmeeinheit (32) wegzuleiten.

IPC 8 full level
F24F 13/22 (2006.01); **F24F 1/20** (2011.01); **F24F 1/36** (2011.01); **F24F 1/58** (2011.01)

CPC (source: EP)
F24F 1/20 (2013.01); **F24F 1/36** (2013.01); **F24F 1/58** (2013.01); **F24F 13/22** (2013.01); **F24F 2221/52** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] EP 2481993 A1 20120801 - FUJITSU GENERAL LTD [JP]
- [X] EP 2180265 A2 20100428 - LG ELECTRONICS INC [KR]
- [X] EP 1684022 A1 20060726 - TOSHIBA CARRIER CORP [JP]
- [X] WO 2016132456 A1 20160825 - MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3473948 A1 20190424; **EP 3473948 B1 20200701**; DE 102017218528 A1 20190418

DOCDB simple family (application)
EP 18199521 A 20181010; DE 102017218528 A 20171017